

ABSTRAK

Perusahaan Sido Agung adalah perusahaan yang memproduksi wafer. Selama ini persentase cacat yang terjadi selama proses produksi cukup tinggi. Hal ini disebabkan karena perusahaan tidak mengetahui faktor-faktor penyebab cacat tersebut karena perusahaan belum mempunyai metode pengendalian kualitas. Dengan adanya permasalahan ini dilakukan usaha pengendalian kualitas dengan menggunakan suatu metode yang cocok.

Karakteristik cacat yang terjadi, yaitu karakteristik cacat atribut, berupa cacat patah, cacat tidak terambil, dan cacat remuk. Dari hasil analisis awal didapatkan bahwa peta kontrol p untuk semua jenis cacat dalam keadaan tidak terkendali. Hal ini disebabkan karena adanya suatu perulangan dalam peta kontrol karena adanya pergantian operator.

Dari diagram ishikawa diketahui bahwa penyebab cacat yang paling dominan adalah karena faktor kelelahan pekerja. Kemudian dibuat suatu rancangan perbaikan, yaitu pembagian beban kerja secara merata di antara para operator, pengaturan aliran udara, dan pemberian kursi bagi operator. Hasil rancangan kemudian diimplementasikan.

Setelah dilakukan implementasi, diperoleh hasil bahwa terjadi penurunan persentase cacat. Jenis cacat patah turun dari 7,1% menjadi 4,88%. Jenis cacat tidak terambil turun dari 4,1% menjadi 2,46%. Jenis cacat remuk turun dari 2,36% menjadi 1,75%. Untuk biaya kualitas terjadi penurunan, yaitu dari Rp 241,22 per kg menjadi Rp 151,55 per kg.

Jadi dapat disimpulkan bahwa hasil dari implementasi perbaikan yang dilakukan untuk memperbaiki kualitas wafer dapat dikatakan cukup berhasil, di mana persentase cacat yang tinggi dapat diturunkan.